

证券代码：688362

证券简称：甬矽电子

## 甬矽电子（宁波）股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-013

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>电话会议</u> ）
参与单位名称及人员姓名	东北证券、广发证券、东方财富、山西证券、上海沁闻、国泰君安、淡水泉、上海煜德、泉果基金
时间	2024年12月
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、副总经理李大林先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1.公司情况简介</b></p> <p>公司从成立之初即聚焦集成电路封测业务中的先进封装领域，车间洁净等级、生产设备、产线布局、工艺路线、技术研发、业务团队、客户导入均以先进封装业务为导向，公司全部产品均为 QFN、LGA、BGA、FlipChip、Bumping、WLCSP 等中高端先进封装形式，并在系统级封装（SiP）、高密度细间距凸点倒装产品（FC 类产品）、大尺寸/细间距扁平无引脚封装产品（QFN/DFN）、晶圆级封装产品（Bumping/WLP）等先进封装领域具有较为突出的工艺优势和技术先进性。凭借稳定的封测良率、灵活的封装设计实现性、不断提升的量产能力和交付及时性，公司获得了集成电路设计企业的广泛认可，并同众多国内外知名设计公司缔结良好的合作关系。</p> <p><b>2.今年营收预期？下游应用领域占比？</b></p>

公司将努力完成股权激励所设定的目标。从营收角度，AIoT 是公司营收占比最高的领域，接近 60%，PA、安防均占比约 15%，运算和车规类产品合计接近 10%。

### **3.PA 领域目前表现如何？后续景气度展望？**

PA 领域需求环比二、三季度有所回暖。今年第四季度，IoT 领域核心客户群的需求相对旺盛，PA 领域的需求也会整体回暖，会综合带动公司四季度营收环比向上。

### **4.稼动率水平？**

整体稼动率处于相对饱满的状态，其中成熟产品线的稼动率持续维持高位，先进封装产能持续爬坡。

### **5.今年的净利润预期？**

今年前三季度归属于上市公司股东的净利润已实现扭亏为盈。未来，公司的利润取决于两个方面，一方面是订单的价格，这个最终取决于市场恢复的一个程度。另一方面，对于公司二期新增的投资，虽然公司的稼动率属于比较饱满状态，但产能存在一个爬坡的过程，同时为新增投资提前储备了生产端的人员以及水电能源等成本，对于公司的毛利率有一定的影响。随着公司营收规模的扩大，会摊掉更多的成本，对毛利率也有一定的正向提升作用。

### **6.今年的折旧水平预期？明年的折旧情况预计？**

随着部分投资陆续达到可使用状态后转入固定资产，公司预估全年整体折旧和摊销水平有所增长。公司预计明年转固和折旧的绝对金额会提升，但随着营收规模的扩大，会覆盖部分新增转固的影响。

### **7.公司各类细分产品有涨价吗？**

价格因产品而异，中高端产品的毛利通常会更高；公司稼动率持续处于高位，战略性放弃了部分毛利率较低的产品，通过增加高毛利产品占比实现整体毛利率回升；此外，对客户导入的新产品的议价空间更大。

**8.再融资募投项目的节奏是怎么样的？**

公司再融资正在积极推进中。相关募投项目后续将根据融资进展和客户需求逐步推进。

**9.Fan-out 目前的进度？为什么公司要扩这条产线？**

Fan-out 在和客户做量产前的验证。随着部分芯片的 IO 密度越来越高，传统封装难以满足封装需求，公司配合部分客户的需求进行了相关产线的建设。

**10.从客户结构来看，IoT 占比的提升是由哪些因素推动的？**

公司 IoT 领域营收占比上升得益于两个方面，一方面是国内 IoT 核心客户市场表现优异，公司作为其核心供应商，伴随客户一起成长；另一方面是台湾客户 IoT 产品线贡献的营收也呈现逐季增长的态势。

**11.明年的终端 IoT 市场和大模型趋势下，公司的优势是什么？**

一方面，公司创始团队年富力强，且核心团队中的大部分人员具备丰富的行业经验、技能、资源，对封测行业有着深刻的理解。另一方面，公司自成立以来专注于先进封装领域的技术创新和工艺改进，在系统级封装（SiP）、高密度细间距凸点倒装产品（FC 类产品）、大尺寸/细间距扁平无引脚封装产品（QFN/DFN）、晶圆级封装产品（Bumping/WLP）等先进封装领域具有较为突出的技术先进性和工艺优势。在不断巩固系统级封装技术优势的同时，公司还积极进行先进晶圆级封装技术储备和产业布局。凭借稳定的封测良率、灵活的封装设计实现性、不断提升的量产能力和交付及时性，公司获得了下游客户的广泛认可，并同众多国内外知名设计公司建立了良好的合作关系，在 AIoT 领域形成了非常优质的客户群体，并作为其核心供应商，伴随客户一起成长。

**12.明年如果 IoT 客户订单放量，我们的产能能否匹配？**

公司相关产能可以满足 IoT 客户需求。目前公司一期的稼动率相对饱和，二期产能持续爬坡，可以承接更多新的订单。

**13.台湾客户订单向国内转移的趋势会持续多久？我们导入的台湾客户情况如何？**

基于各种因素影响，多家客户均在积极布局 local-for-local 的供应链模式，在该趋势下，预计未来 2-3 年公司海外营收占比将持续提升；目前服务的台湾客户涉及 TV、WiFi、通信芯片等多领域。

**14.二期产能的投产进度如何？对营收的贡献有何预期？**

二期基建部分已基本完成，后续投资主要是先进封装的设备以及厂房装修，公司将根据终端市场的需求变化情况，审慎稳妥控制投资节奏。目前公司未对二期的营收进行单独核算。

**15.目前 2.5D 和 3D 封测的进展如何？有哪些客户导入？**

公司目前在 2.5D 方面的布局目前已经通线，核心设备已经全部 move-in，已经具备通线能力，正在积极与客户对接；主要为国内的运算类客户、AP 类 SoC 客户等。

**16.封测价格和盈利趋势如何？**

整体而言，公司产品价格相对稳定。公司坚持中高端封测的定位，IoT、运算类和车规领域的增长将进一步提升盈利能力。

**17.明年增长的主要驱动因素是什么？**

从下游需求来看，公司将随着 IoT 客户共同成长，车规和运算类客户占比低但增速快，明年海外客户的营收贡献也继续上升。

**18.高毛利业务是否会受到竞争影响？**

	<p>竞争是客观存在的。公司将持续通过研发投入、精益管理、降本增效等多种方式，持续提升公司核心竞争力。</p> <p><b>19.封测产品的毛利率为何高于国内其他同行？</b></p> <p>一方面公司产品结构优异，坚持做技术难度大、毛利率高的产品。另一方面，公司治理结构良好、管理层经验丰富，在效率、成本、良率上具备优势，因此能在折旧规模巨大的情况下维持行业内较高的毛利水平。</p> <p><b>20.公司是否计划布局 HBM 技术？</b></p> <p>在技术方面，部分 HBM 产品与 2.5D 封装的工艺和设备部分通用；商务角度，HBM 客户主要为存储类公司，区别于公司目前的 SoC 类客户群体，公司暂时处于观望状态。</p> <p><b>21.市场景气度如何？订单能见度是多久？</b></p> <p>目前 IoT 领域核心客户群的需求相对旺盛，PA 领域的需求整体回暖。公司订单能见度通常为三个月。</p> <p><b>22.公司在先进封装领域的布局进展如何？</b></p> <p>公司在 2.5D 和 3D 封装领域已完成初步布局，相关设备已 move in 并通线，正在与客户共同开发并进行工艺验证。先进封装的核心壁垒在于良率稳定性和高效的工艺水平。</p> <p><b>23.公司生产是否具有季节性特点？</b></p> <p>公司生产具有一定的季节性特征。四季度为全年旺季，需求较为集中；一季度通常是淡季，主要受春节假期影响，生产天数减少。由于生产天数和客户节奏的限制，一季度环比下降是正常现象，但整体需求仍保持强劲。</p> <p><b>24.折旧费用对公司盈利能力的影响有多大？</b></p> <p>二期项目的大量设备投入是当前折旧增长的主要原因。随着产能爬坡，规模效应显现，新增投资的边际影响逐步变小，毛利率逐步上升。</p>
附件清单（如有）	无

日期	2024 年 12 月 6 日、12 月 10 日和 12 月 11 日
----	--------------------------------------